



平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年2月7日

上場取引所 東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社

コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁

問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤 TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成30年2月13日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無：無

四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第3四半期	7,849	14.8	△92	—	△102	—	△292	—
29年3月期第3四半期	6,834	7.3	△314	—	△279	—	△310	—

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 △239百万円 (—%) 29年3月期第3四半期 △550百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第3四半期	△23.55	—
29年3月期第3四半期	△24.98	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第3四半期	12,303	3,455	28.1	278.24
29年3月期	12,477	3,695	29.6	297.55

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 3,455百万円 29年3月期 3,695百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
30年3月期	—	0.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	12,500	12.6	300	△24.4	290	△26.8	140	△58.2	11.27

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正については、平成30年2月7日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社 （社名）、除外 一社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	30年3月期3Q	12,969,000株	29年3月期	12,969,000株
② 期末自己株式数	30年3月期3Q	549,573株	29年3月期	549,573株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年3月期3Q	12,419,427株	29年3月期3Q	12,419,951株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手できる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	9
(参考資料)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

過年度において不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、過年度の決算訂正を行い、平成29年7月31日に、「平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正第3四半期決算短信を提出しております。これにより、前年同四半期数値及び前年同四半期比につきましては、訂正後の数値をもとに記載しております。

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、引続き政治的リスク、地政学的リスクが懸念されますが、欧米では内需の底堅さなどから景気回復が続いており、中国は各種政策の効果により景気は持ち直しの動きが見られ、新興国経済も総じて穏やかな回復傾向が続きました。一方、わが国経済も、個人消費は依然弱いものの、企業収益及び雇用環境の回復により、穏やかな回復基調で推移してまいりました。

こうした環境の中で、当社グループの主たる供給先である半導体業界は、需要の旺盛なフラッシュメモリを中心に設備投資が拡大し、また中国においては、国の支援もあり半導体メーカーの設備投資が本格化してきております。また、自動車業界に関しては、自動車の高機能化による電子制御装置の増加や、電気自動車・ハイブリッド車の増加により、車載用センサーやインバーターをはじめとする電子部品需要が拡大するとともに、需要先も国内から欧州、アジアの車載半導体関連メーカーに拡大し堅調に推移しております。当社は車載向けを想定して開発した大型モジュール用モルディングシステム「GTM-170T」及び高速デバイスマウンター「ADM-2000」など好調な動きとなっております。

一方、スマートフォン向けに関しては、当社が開発したWLP(ウェハーレベルパッケージ)用コンプレッションモールド装置の「WCM-300L」は、スマートフォン向けCPU等先端パッケージに加え、新たにメモリーにも採用されるなどその用途が拡大するとともに、多くの半導体メーカーより引合いをいただいておりますが、中国を中心とするスマートフォンの在庫調整が長引いたことから、半導体メーカーにおいてスマートフォン関連の半導体への設備投資が想定した当第3四半期においても本格化せず遅れが発生しました。この影響を大きく受け、スマートフォン向けを想定した装置の受注が想定を下回る動きとなりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は7,849百万円(前年同四半期比14.8%増)、営業損失は92百万円(前年同四半期は営業損失314百万円)、経常損失は102百万円(前年同四半期は経常損失279百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は292百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失310百万円)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注環境は、車載向け装置はマーケットの拡大とともに引続き順調な動きとなっております。一方、当社が強みとしているWLP(ウェハーレベルパッケージ)を始めとする高機能向けスマートフォンのパッケージ向け装置に関しては、中国を中心にスマートフォンの在庫調整が解消しないこと、その後のスマートフォンの新製品の動きも期待を下回る動きとなっていることから、顧客メーカーの投資判断が遅れており、残念ながら本格的な動きは翌会計年度(平成30年4月以降)にずれ込む見込みです。

また、景気回復とともに装置に使用する部材の調達長期化していること、当社の制度の改定により、売上を計上するための検収手続きが長期化していること等により、納期及び売上の遅延が発生しており、売上及び利益は当初想定を下回りました。

この結果、売上高は6,670百万円(前年同四半期比17.5%増)、セグメント利益は355百万円(前年同四半期比37.9%増)となりました。

②電子部品

半導体等向けのリードフレームに関しては、底打ちの傾向が見られましたが、銅材等の資材価格が値上がりし、損益面で影響を与えました。一方、前連結会計年度に実施したLPS(LEDプリモールド基板)事業の人員を含む生産体制の大幅な縮小により、赤字幅は縮小いたしました。

この結果、売上高は857百万円(前年同四半期比2.1%増)、セグメント損失は70百万円(前年同四半期はセグメント損失144百万円)となりました。

③その他

その他につきましては、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の販売であります。リードフレームを使用する半導体の設備投資につきましてはマーケットが限られており、また、リード加工金型は当面の需要の一巡感もあることから低調に推移しました。

この結果、売上高320百万円(前年同四半期比0.8%増)、セグメント利益は45百万円(前年同四半期比125.5%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、12,303百万円（前連結会計年度末は12,477百万円）となり、前連結会計年度末と比較して174百万円減少いたしました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、8,848百万円（前連結会計年度末は8,782百万円）となり、前連結会計年度末と比較して65百万円増加いたしました。これは主に、買掛金の増加によるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、3,455百万円（前連結会計年度末は3,695百万円）となり、前連結会計年度末と比較して239百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は28.1%（前連結会計年度末は29.6%）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

中国を中心とするスマートフォンの在庫調整が長引いたことから、半導体メーカーにおいてスマートフォン関連の半導体向け設備投資が当第3四半期においても本格化せず想定以上の遅れが発生しました。この要因により当社の主力製品のひとつであるウェエハーレベル用コンプレッションモールド装置の受注が想定を下回る動きとなりました。なお、本格的に業績に寄与する時期は翌会計年度(平成30年4月以降)にずれ込む見込みです。

また、景気の回復とともに装置に使用する部材の調達が長期化していること、当社の制度の改定により売上を計上するための検収手続きが長期化していること等により、納期及び売上の遅延が発生しており、現時点で解消できておりません。

これらの状況を踏まえ、通期見直しを見直した結果、下記のとおり平成29年7月31日に公表した業績予想の見直しを行い、平成30年2月7日に業績予想の修正の公表をいたしました。

平成30年3月期 通期業績予想の修正（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A) (平成29年7月31日公表)	14,000	910	920	750	60.39
今回修正予想 (B)	12,500	300	290	140	11.27
増減額 (B-A)	△1,500	△610	△630	△610	—
増減率 (%)	△10.7	△67.0	△68.5	△81.3	—
(ご参考) 前期実績 (平成29年3月期)	11,098	397	396	335	26.99

(注) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見直しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,592,015	2,636,130
受取手形及び売掛金	2,419,331	1,755,280
商品及び製品	2,419,909	1,780,974
仕掛品	1,946,005	2,600,177
原材料及び貯蔵品	186,014	419,825
その他	141,920	141,613
貸倒引当金	△510	△510
流動資産合計	9,704,687	9,333,492
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	801,977	757,124
機械装置及び運搬具(純額)	299,336	403,926
土地	484,534	484,534
その他	164,211	235,340
有形固定資産合計	1,750,059	1,880,927
無形固定資産	65,286	113,650
投資その他の資産		
その他	962,327	978,978
貸倒引当金	△4,436	△3,350
投資その他の資産合計	957,891	975,628
固定資産合計	2,773,237	2,970,206
資産合計	12,477,924	12,303,699
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,313,412	2,211,736
短期借入金	2,934,000	3,070,000
1年内返済予定の長期借入金	173,410	159,600
未払法人税等	47,468	22,464
賞与引当金	114,086	59,503
製品保証引当金	48,272	61,320
前受金	1,371,486	1,444,458
その他	277,768	387,083
流動負債合計	7,279,904	7,416,166
固定負債		
長期借入金	637,100	517,400
退職給付に係る負債	702,048	678,199
その他	163,515	236,303
固定負債合計	1,502,663	1,431,902
負債合計	8,782,568	8,848,068

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	△1,734,381	△2,026,858
自己株式	△101,247	△101,247
株主資本合計	4,001,870	3,709,393
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	18,123	33,084
為替換算調整勘定	△311,678	△284,603
退職給付に係る調整累計額	△12,959	△2,243
その他の包括利益累計額合計	△306,514	△253,762
純資産合計	3,695,355	3,455,630
負債純資産合計	12,477,924	12,303,699

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売上高	6,834,516	7,849,246
売上原価	5,458,877	6,200,267
売上総利益	1,375,639	1,648,978
販売費及び一般管理費	1,690,228	1,741,256
営業損失(△)	△314,589	△92,278
営業外収益		
受取利息及び配当金	3,566	3,447
為替差益	48,839	3,939
受取技術料	6,458	14,042
受取賃貸料	17,972	9,502
その他	25,213	23,452
営業外収益合計	102,050	54,384
営業外費用		
支払利息	56,022	57,313
持分法による投資損失	2,730	4,643
その他	8,522	2,839
営業外費用合計	67,274	64,795
経常損失(△)	△279,814	△102,689
特別利益		
固定資産売却益	1	7,667
特別利益合計	1	7,667
特別損失		
固定資産売却損	662	7
減損損失	※ 22,000	—
過年度決算訂正関連費用	—	166,652
特別損失合計	22,662	166,660
税金等調整前四半期純損失(△)	△302,475	△261,682
法人税、住民税及び事業税	8,162	21,297
法人税等調整額	△329	9,497
法人税等合計	7,833	30,794
四半期純損失(△)	△310,308	△292,476
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△310,308	△292,476

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
四半期純損失(△)	△310,308	△292,476
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	23,573	14,960
為替換算調整勘定	△157,331	20,560
退職給付に係る調整額	7,518	10,716
持分法適用会社に対する持分相当額	△114,256	6,514
その他の包括利益合計	△240,497	52,751
四半期包括利益	△550,805	△239,725
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△550,805	△239,725

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結損益計算書関係)

※ 減損損失

前第3四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	場所	種類	金額(千円)
事業用資産	アピックヤマダ株式会社 吉野工場	建物、機械装置、土地等	22,000

当社グループは、事業用資産については、工場ごとにグルーピングしております。

事業用資産のうち、電子部品事業に供している吉野工場について収益環境が悪化したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少価額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物3,281千円、機械装置及び運搬具8,606千円、土地3,564千円、リース資産5,487千円、その他固定資産1,059千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、処分価額又は鑑定評価額であります。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他(注)	
売上高				
外部顧客への売上高	5,675,531	840,537	318,447	6,834,516
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,487	6,494	262	9,244
計	5,678,018	847,032	318,710	6,843,761
セグメント利益又はセグメント損失(△)	257,732	△144,964	20,031	132,799

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	132,799
セグメント間取引高消去	-
全社費用(注)	△447,389
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△314,589

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「電子部品」セグメントにおいて固定資産の減損損失を計上しております。尚、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては22,000千円であります。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他(注)	
売上高				
外部顧客への売上高	6,670,416	857,885	320,944	7,849,246
セグメント間の内部売上高又は振替高	156	2,706	107,921	110,784
計	6,670,572	860,592	428,866	7,960,030
セグメント利益又はセグメント損失(△)	355,456	△70,991	45,166	329,631

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	329,631
セグメント間取引高消去	—
全社費用(注)	△421,909
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△92,278

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

(参考資料)

受注及び販売の状況

当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)の受注及び販売の実績は次のとおりです。

(1)受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	6,169,909	81.2	86.4
電子部品	869,658	11.4	99.4
その他	562,842	7.4	155.3
合計	7,602,411	100.0	90.8

(2)受注残実績

セグメントの名称	受注残高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	5,794,085	92.0	75.0
電子部品	126,046	2.0	122.1
その他	377,308	6.0	178.1
合計	6,297,440	100.0	78.3

(注) 当第3四半期連結期間の末日の受注残高

(3)販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	6,670,416	85.0	117.5
電子部品	857,885	10.9	102.1
その他	320,944	4.1	100.8
合計	7,849,246	100.0	114.8